

DJ-801 型硅片倒角机

该机主要用于直径 4 英寸~8 英寸硅片、玻璃圆片等硬脆材料的边缘磨削。

● 主要技术特点：

1. 采用高精度激光传感器对晶片进行定位；
2. 全自动加工过程并实时监控加工状态；
3. 片盒取完或装满时自动提示。
4. 高精度磨轮轴及磨轮进给系统保证了晶片磨削精度；
5. 可自动上下片，对磨削后的晶片可自动清洗。

● 主要技术指标：

- 晶片直径：4~8 inch
- 晶片厚度：0.6~1.2 mm
- 晶片形状：带定位边硅片，圆片
- 磨轮外径：200mm
- 磨轮旋转速度：5000 r/min
- 磨轮外型：R 型、T 型磨轮
- 片厚测定分辨率：0.1 μm
- 片厚测定进给步距偏差：±2 μm
- 磨轮主轴上下移动分辨率：1 μm
- 送片工作台旋转分辨率：0.001°
- 清洗甩干工作台旋转速度：0-3000 r/min
- 承片台转速：≤200r/min
- 磨轮主轴上下运动：AC 伺服电机
- 承片台 X-Y 向运动分辨率：1 μm
- 承片台 X-Y 向运动：AC 伺服电机
- 承片台中心定位精度：±50 μm
- 外形：1500mm×1000mm×1800mm
- 重量：1500kg

